

(8) - 1

2023年国際特許分類サブクラスに基づく特許新規出願件数ランキング
(前20位)

順位	国際特許分類 (サブクラス)	分類内容の概要	件数
1	H01L	半導体装置；他に包含されない電氣的固体装置	5,496
2	G06F	電氣的デジタルデータ処理	2,558
3	A61K	医薬用，歯科用又は化粧用製剤	2,032
4	G06Q	電子商取引	1,153
5	G02B	光学要素，光学系，または光学装置	1,126
6	G03F	フォトメカニカル法によるパターン化された表面； そのための材料；そのための原稿；そのために特に 適合した装置	910
7	H05K	印刷回路；電氣装置の箱体または構造的細部，電氣 部品の組立体の製造	864
8	C07D	複素環式化合物	812
9	C23C	金属質材料への被覆；金属質材料による材料への被 覆	805
10	H10D	無機電氣的半導体装置	798
11	H04W	無線通信ネットワーク	765
12	H04N	画像通信	759
13	C07K	ペプチド	727
14	H10B	電子記憶装置	715
15	C08G	炭素－炭素不飽和結合のみが関与する反応以外の反 応によって得られる高分子化合物	681
16	G01N	材料の化学的または物理的性質の決定による材料の 調査または分析	672
17	G01R	電氣的変量の測定；磁氣的変量の測定	657
18	B32B	積層体、すなわち平らなまたは平らでない形状	630
19	H01J	電子管または放電ランプ	623
19	H04L	デジタル情報の送信	623

統計資料：2025年1月11日

注：

1. 特許出願件数に基づくランキング
2. 詳細な国際特許分類内容の描述は国際特許分類第 2024.01 版参照
3. 新規出願の分類の時間差により、リアルタイムで当年度年報の件数を提供できない
ので、年報の年度における一年前の件数を統計の根拠とする。